## **DEVELOPMENT OF A COMPACT SWITCHING POWER SUPPLY FOR** THE KEK DIGITAL ACCELERATOR UTILIZING A SiC-JFET

Katsuya Okamura<sup>#,A)</sup>, Toshiya Mizushima<sup>B)</sup>, Koichi Takaki<sup>C)</sup>, Taiki Iwashita<sup>D)</sup>, Masayoshi Wake<sup>A)</sup>, Ken Takayama<sup>A)</sup>

A) KEK

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801 <sup>B)</sup> Hitachi, Ltd 3-1-1 Saiwai-Cho, Hitachi, Ibaraki, 317-8511 <sup>C)</sup> Iwate University 3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate, 020-8550 <sup>B)</sup> Nippon Advanced Technology 3-1-1 Tokai-Mura, Naka-Gun, Ibaraki, 319-1112

Abstract

Utilizing a high power discrete SiC-JFET developed by KEK, a switching power supply (SPS) that had a circuit topology of H-bridge was designed and constructed to drive the induction acceleration system for the KEK digital accelerator. The SPS was operated with a 38  $\Omega$  dummy resistance load and bipolar outputs of 800V and 21A were successfully demonstrated at 1 MHz. Also, combination test with an actual induction cell was demonstrated.

# SiC-JFET を用いた KEK デジタル加速器(DA)用小型パルス電源

#### はじめに 1.

KEK デジタル加速器(DA)は線形加速器やブース ターなどの入射装置を必要としない誘導加速シンク ロトロン (IS) である<sup>[1]</sup>。 IS は KEK において 2000 年にその概念が提案され<sup>[2]</sup>、2006年に原理実証され た<sup>13</sup>誘導加速を前提にしたシンクロトロンであり、 誘導加速セルと呼ばれる 1:1 トランスを介して矩形 パルス電圧によって荷電粒子の加速と閉じ込めを行 う(図1)。現在 DA は精力的にビームコミッショ ニングが行われているところであるが、将来はイオ ン種に関わらずいかなる荷電粒子でも加速可能とい うその特徴を生かし、総合研究大学院大学の学融合



図1:誘導加速シンクロトロンの原理



KEK デジタル加速器 図2:



Switching arm S1 (7 MOSFETs in series) 従来型 SPS 図3:

研究プロジェクト「模擬宇宙線による実験室宇宙科 学の展開」に供される初の実用型誘導加速シンクロ トロンとなる計画である<sup>[4]</sup>。図2に KEK デジタル加 速器の概要を示す。

上に述べたように DA において誘導加速セルとそ れを駆動するパルス電源は本質的に重要なコンポー ネントであり、これらの信頼性を高めることが IS を高エネルギーイオン源として活用していくための 重要な課題である。

ところでこれまでの IS においては原理実証器、 そして現在開発しているデジタル加速器においても パルス電源(Switching Power Supply: SPS)には Si-MOSFET (IXYS, DE454-102N20A, 1000V-20A)を用い た単相フルブリッジ電源が用いられている<sup>[5]</sup>。図 3 にこのスイッチング電源の外観を示す。このスイッ チング電源では MOSFET1 素子あたりの耐電圧及び 放熱容量の観点から7個の素子を直列接続すること によりパルス電源の1アームを形成する構成となっ ている、即ちパルス電源1台当たり28個の MOSFET を用いている。各 MOSFET にはそれぞれ 独立した駆動回路とその電源回路が必要であるため 全体に装置が大型化し、さらに駆動パルスを伝送す るために 28 本もの光ケーブルを敷設する必要が あった。また直列接続された各 FET の分担電圧を平 準化するために並列に静電容量を付加する必要があ りこの調整にも多くの時間を要する等の課題があっ た。

そこで我々は Si-MOSFET に置き換わる素子とし て SiC-JFET の採用を検討し、デバイスメーカーが サンプル出荷した素子を用いてその性能評価を行っ た結果、SPS 用スイッチング素子として有望である ことを見いだした<sup>[6]</sup>。しかしながら評価用素子は連 続通電時に発生する損失に耐える放熱性能が不十分 であったため、我々は新規にパッケージも含めた開 発に着手し,その結果良好な性能評価結果を得た<sup>[7]</sup>。 本論文ではこの新 SiC-JFET を用いた SPS の性能評 価結果、さらには実誘導加速セルとの組み合わせ試 験結果について述べる。

# スイッチング電源 (SPS)の設計と試 作

#### 2.1 SiC-JFET

現在高速スイッチング素子として広く普及している Si-MOSFET はその性能的限界に近づいていることが指摘されており、その限界を打ち破る素子として SiC 素子に対する期待が高まっている<sup>[8]</sup>。SiC は Si と比較すると絶縁破壊電界が 10 倍、電子のドリフト速度が 2 倍、熱伝導率が 3 倍と高いため<sup>[9]</sup>、パワーデバイスの材料としてより理想に近い物であるということが出来る。図3に開発した SiC-JFET パッケージの外観を示す<sup>[10]</sup>。パッケージ外形は 65mmx45mm である。図3において左側は完成した パッケージ、右側は内部構造が分かるように最終の エポキシモールド工程前のものである。デバイス



チップには 4.3mm 角のノーマリーオン型の SiC-JFET を用いており、これは SiCED 社(独)によっ て開発されたものである。図 5 に試作デバイスのス イッチング波形の例を示す。電流の立ち上がり、立 ち下がりとも 50ns 以下の高速スイッチングが可能



表1:試作デバイスの性能

Parameter	Value	Unit
Blocking Voltage	1200	V
Pinchi-off Voltage	-17	V
On Resistance (@150°C)	0.2	Ω
Thermal Resitance, junction to case	0.56	K/W
Power Dissipation	>250	W

であることが確認された。また連続スイッチング実験にも供された。図 6 に連続スイッチング実験を行ったときの温度上昇特性を示す。図 6 において温度はケース上面のモールド部にセンサー用穴を穿ち、デバイスチップ直上約 1mm のところを光ファイバー温度計で測定したものである。熱解析の結果、1MHz 動作のときの素子の最高温度は 183℃と評価された。表1に開発 JFET の性能指標一覧を示す。



2.2 SPS の設計と製作

図 7 に SPS の回路構成を示す。各スイッチング アームは水冷ヒートシンクにマウントされた SiC-JFET、絶縁型 dc コンバータで電源供給されるゲー トドライブ回路で構成されている。駆動信号は光 ファイバーを通じて送信される。またスイッチング 時の過電圧を抑制するため非放電型の CRD スナ バー回路が備えられている。 高速スイッチング回路では配線の寄生インダクタ ンスを極力小さくすることが不要な電圧振動や過電 圧をなくする上で重要である。そのような寄生イン ダクタンスを極小化するために厚さ 0.25mm のノー メックス紙<sup>®</sup>2枚を挟んで絶縁されたペア銅板配線 が採用された。図8に SPS の平面レイアウトを示す。 回路中の主要な通電部分は互いに逆方向に電流が流 れる銅板が重なっているため、寄生インダクタンス の極小化が実現されている。

### 3. 試作 SPS の評価

#### 3.1 抵抗負荷試験

最初に負荷として抵抗を接続してスイッチング実 験を実施した。図9に入力直流電圧800V、繰り返 し周波数1 MHzのときの出力電流波形とFET1の電 圧波形を示す。若干の電圧振動が見られそのために FETのピーク電圧Vdspは入力電圧よりも高くなっ ているが、FETの定格電圧(1.2kV)には余裕がある。 この振動は配線インダクタンスとキャパシタンスの 間でのスイッチングエネルギーの充放電によって発 生しているものと考えられる。この現象を理解する ため、回路シミュレーションを実施した。シミュ レーションにおいてはインダクタンス、キャパシタ ンスの値は半実験的に決定した。シミュレーション 結果を図10に示す。シミュレーションにおいても 実測と同様の電圧振動が起きることが確認できた。



図8: SPS の平面レイアウト



上)出力電流、(下)FET1のドレイン電流

#### 3.2 実セル通電試験

つぎに実際の加速器で用いているのと同じ誘導加 速セルを負荷としてスイッチング実験を実施した。 実験回路を図 11 に、測定の状況を図 12 に示す。 SPS と負荷セルの間には実加速器を想定して長さ約 30m のケーブルを接続した。ケーブルのインピーダ ンスは公称 125 Ω であり、伝搬時間は実測で約 150ns であった。加速セルは外形 500mm、内径 225mm、厚さ 15mm のトロイダル状にファインメッ ト®6 個を巻回したコアをギャップ付きのタンクに 収納したものである。また一次側の励磁巻線として 銅板による 1 ターンのコイルがコアとタンクの間に 巻回されている。さらに二次側に誘導される電圧を 測定するために 1 ターンの測定コイルを巻回した。

スイッチング実験に先立ち加速セルの一次側から みたインピーダンス測定を行った。図 13 に結果を 示す。図 13 においてプロット点は実測値であり、 実践はセルの等価回路をインダクタンス 70μH、抵 抗 400Ω、キャパシタンス 90pF の並列回路と考えた 時の計算値を表しており、周波数により若干の違い はあるが概略この等価回路で考えてよいと思われる。 ケーブルの特性インピーダンスとの整合をとるため



図11:実加速セル組み合わせ実験回路



図12:組み合わせ実験の様子



図 14 : 加速セルのインピーダンス特性

にセルと並列にマッチング抵抗(150Ω)を接続した。

測定波形の例を図 14、図 15 に示す。これらの図 は加速セルの一次側電圧と二次側電圧、励磁電流、 マッチング抵抗の電流を示している。但し図 14 は 二次コイルに負荷抵抗 300Ωを接続した場合であり、



 図 14: SPS と実セルの組み合わせ実験波形 (二次抵抗: 300Ω)
(上) 一次電圧(青)、二次電圧(赤)
(下) セル励磁電流(青)、整合抵抗電流(緑)



図 15 は同1 k Ωの場合である。これらの結果より誘 導加速セルの一次側から二次側への電圧伝達効率は ほぼ 100 %近いことが分かる。但し、電圧の立ち上 がり部分において二次側の抵抗が 1k Ωの場合には 25 %のオーバーシュートが発生している。このよう なオーバーシュートが発生するのは二次側のイン ピーダンスが高いために何らかの反射のような現象 が発生しているためではないかと思われるが今後の 研究課題である。

#### 4. まとめ

従来の Si-MOSFET を用いた SPS を置き換えるために SiC-JFET を用いた SPS の試作を行った。試作した SiC-JFET 方式の SPS は模擬負荷を接続して 800V-1MHz の安定な動作が確認された。また、実際の加速器に用いられている誘導加速セルを接続した実験も行われた。

本 SPS を用いて誘導加速セルの研究を行うととも に、実際のビーム加速実験にも供したいと考えてい る。また、1アームあたりの素子数を3個程度に増 やすことで電圧耐量を高くし、Si-MOSFETの完全な 置き換えを実現したい所存である。

謝辞: 本研究は,科学研究補助金(基盤研 B24310077)の援助を受け行われた。

#### 参考文献

[1] T. Iwashita et al., "KEK Digital Accelerator", Phys. Rev. ST-AB 14, 071301 (2011).

[2] K.Takayama and J.Kishiro, "Induction Synchrotron", Nucl. Inst. Meth. A 451, 304 (2000).

[3] K.Takayama, Y.Arakida, T,Dixit, T.Iwashita, T.Kono, E.Nakamura, K.Otsuka, Y.Shimosaki, K.Torikai, and M.Wake, "Experimental Demonstration of the Induction Synchrotron", Phys. Rev. Lett., 98, p054801-4 (2007)

[4] 高山、岡村:「デジタル加速器と次世代高繰り返 しスイッチング電源」,電学論 A, Vol.132, No.1 pp.13-16 (2012)

[5] 小関、高山、:「誘導加速シンクロトロンのための MH 動作高電圧パルス電源の開発」,電学論 A, Vol126-A, No. 3, pp121-126 (2006)

[6] K. Ise, H. Tanaka, K. Takai, M. Wake, K. Okamura, K. Takayama, and Wl Jiang : " Development of a Megahertz High-Voltage Switching Pulse Modulator Using a SiC-JFET for an Induction Synchrotoron", IEEE Trans. Plasma Sci., Vol.39, No.2 pp.730-736 (2011)

[7] K. Okamura, K. Ise, M. Wake, Y. Osawa, K. Takaki, and K. Takayama : "Characterization of SiC JFET in novel packaging for 1 MHz Operation", Materials Science Forum Vols.717-720 pp 1029-1032 (2012)

[8] K. Shenai, R. S. Scott, and B. J. Baliga: "Optimum Semiconductors for High-Power Electronics, IEEE Trans. Electron Devices,, Vol.36, No.9 pp.1811-1822 (1989) [9] 松波弘之:半導体 SiC 技術と応用,日刊工業新聞 社 (2003)

[10] K. Okamura et al, "Novel Package of SiC-JFET for a Switching Pulse Supply Operating at 1 MHz for an Induction Synchrotron", IEEE Trans. Plasma Sci., to be published